

GENIDEAS[®]

聚賢研發股份有限公司

2026第三季法人說明會

股票代號 **7631**



反省



創新



即時



共好

免責聲明



- 本簡報相關訊息內容取自於公司內部與外部蒐集之資料，其中包含營運成果、財務狀況、業務發展與產業現況等內容。
- 本公司並未發佈財務預測，本簡報所作有關本公司財務、業務或Q&A之說明，若涉及本公司對未來公司經營與產業發展之見解，可能與未來實際結果存有差異，造成差異之原因可能包括科技演進、市場需求變化、原料價格波動、競爭行為與國際經濟景氣變動等各種風險因素。
- 本簡報內容並非投資建議，本公司不對內容的正確性、完整性或任何使用本簡報內容所產生的損害負任何責任。

大綱



01

公司簡介

02

營運策略與研發能力創新

03

創新產品與專利

04

聚賢永續行動

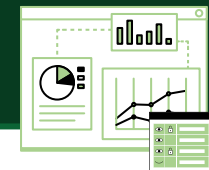
05

業務發展暨財務績效

01.公司簡介



公司基本資料



經營團隊

董事長 曾國強 | 總經理 鄭惠芸



公司成立

2018年1月



上市日期

2025年3月13日



全球員工人數

170人



資本額

NTD 2.01億



廠務工程

- 高科技廠房MEP機電工程
- 高科技廠房整合二次配系統裝機工程
- 高科技廠房氣體供應系統設計施工工程



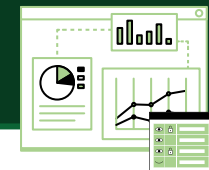
設備及零組件 設計開發

- 管路工藝流程優化，機構及輔治具開發
- 製程設備零組件及耗材設計開發
- 全方位售後服務與技術支持



跨領域技術 整合創新應用

- 半導體雷射技術延伸應用
- 自動化與智慧製造整合
- 客製化技術解決方案



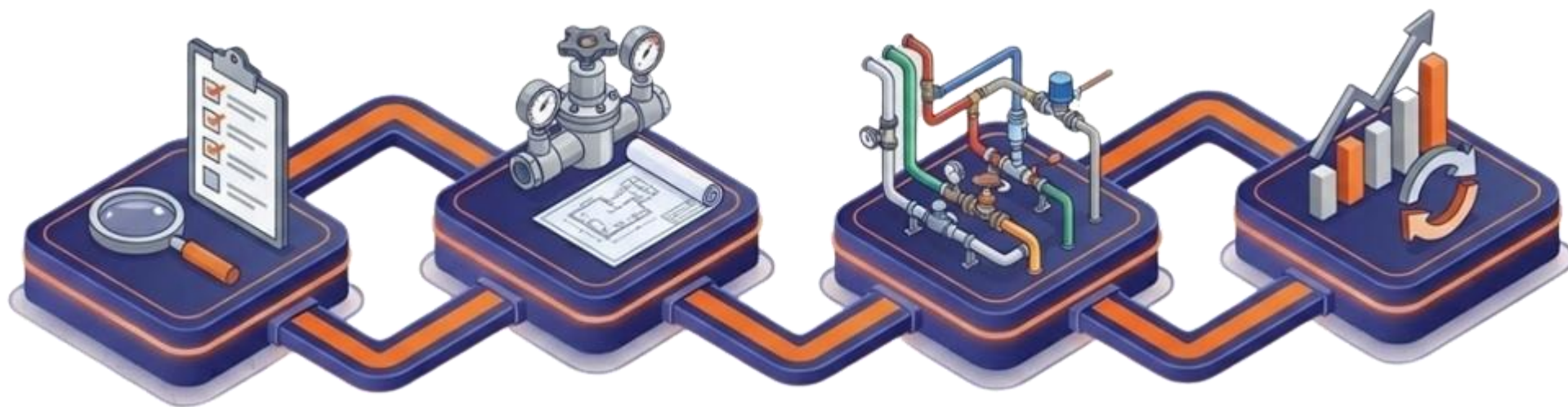
跨領域關鍵技術服務與創新產品

從使用者需求
與問題出發

製程設備所需
零組件耗材
設計開發製造

高科技廠房
MEP機電
供應系統領域佈局

全方位
售後服務
技術支持



創新優化客戶生產流程及設備

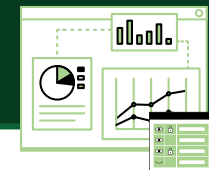
引導改良氣體二次配工程施作



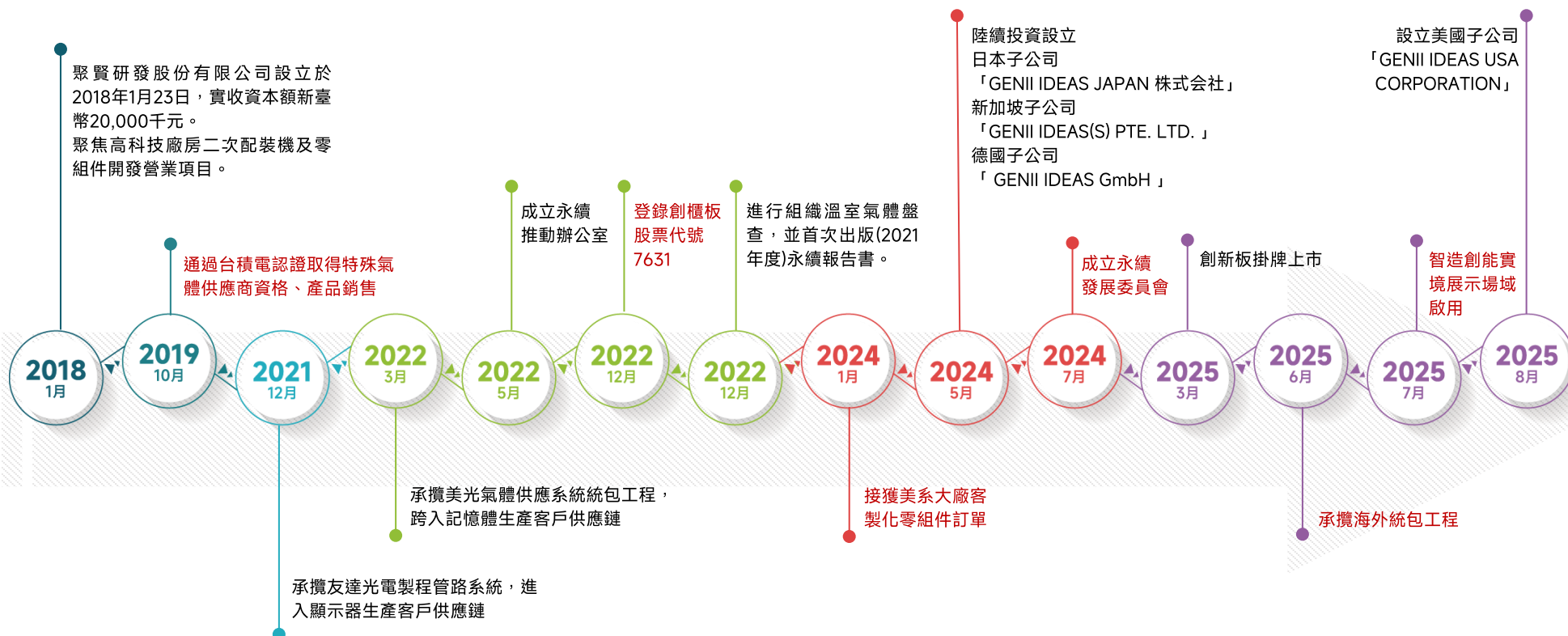


因應氣候變遷及行動下

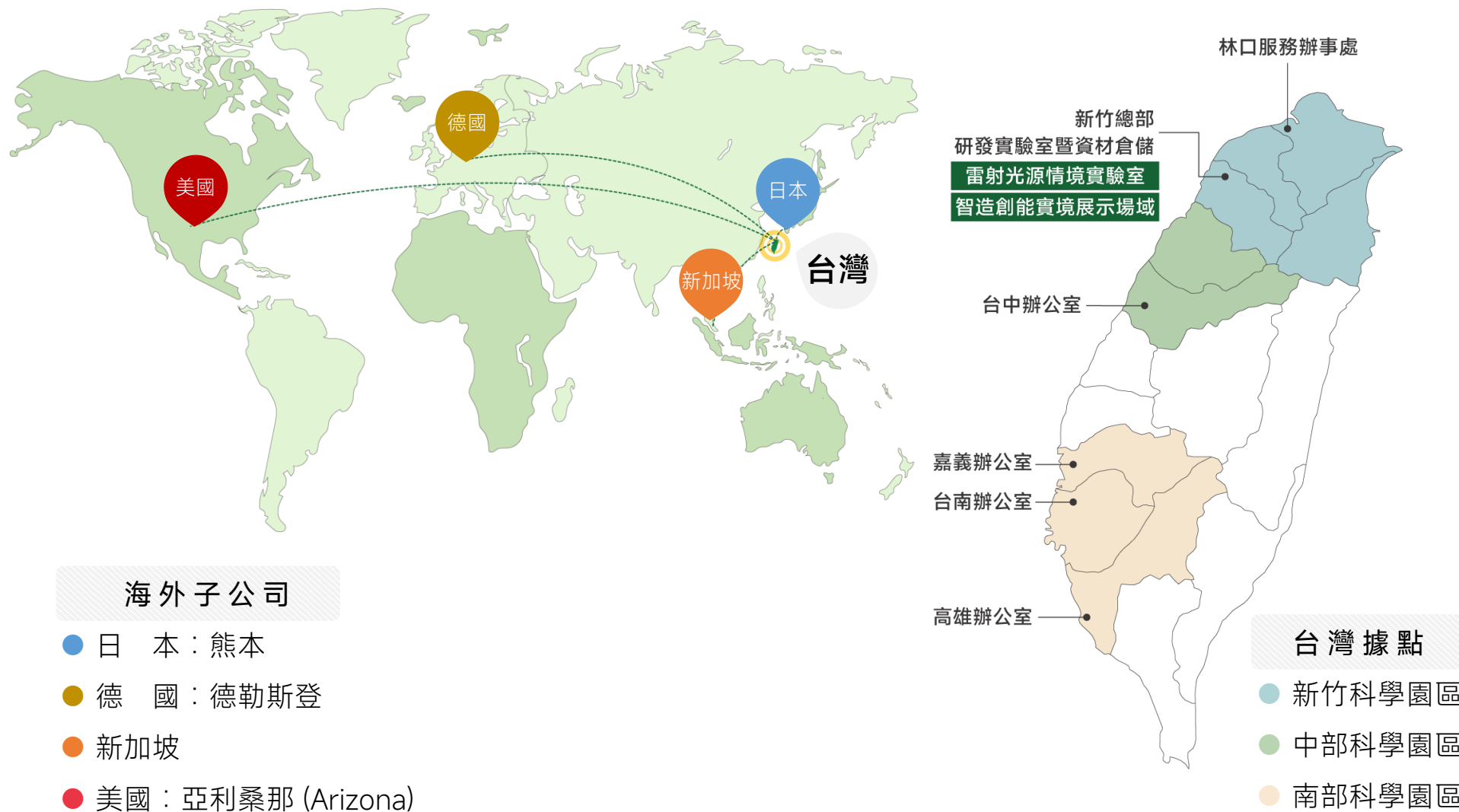
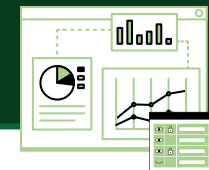
「高科設備優化最佳服務商」



公司經營重要歷程

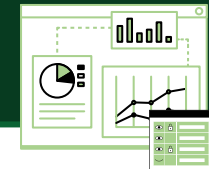


全球服務據點



02. 營運策略與研發能力創新





新市場 / 新客戶

跨國廠務佈局：開拓日本、新加坡、德國、美國之廠務工程及技術服務市場

設備通路推廣：透過日本代理商，推廣新型端面機、雷射焊接機等設備通路

探索未來事業



第三代太陽能(鈣鈦礦)與智慧應用：智慧農業(低碳自供電溫室)、智慧建築(創能門窗發電應用)

再生能源與環保技術：氫氣與氨氣回收純化再利用、超臨界CO2清洗或材料萃取



深化現有事業

- 持續改善營運流程，提升工程服務綜效
- 投入研發資源
- 提供製程設備與零組件營收比重

新服務 / 新產品

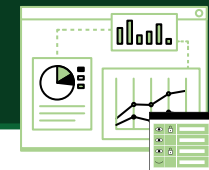


雷射技術跨產業應用：管路精密焊接、極細金屬線材切割、電性量測、玻璃切割

多系統整合：提供機電、製程冷卻水之整合性二次配工程服務

客製化解決方案：管路抗結晶機構、半導體精密固定件、高精度對位治具開發與全方位售服技術支持

企業營運 成長策略



整合智慧農業與智慧建築，打造零碳排生態圈

智慧農業 | 低碳自供電型溫室

攜手工研院

農電共生

將鈣鈦礦技術導入沙崙綠能示範場域的溫室

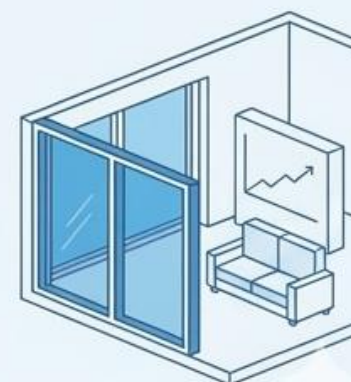
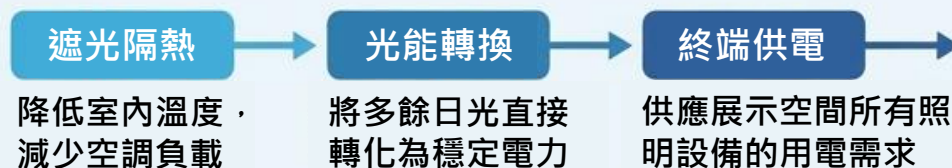
- ✓ 實現高經濟作物的低碳與綠能生產
- ✓ 溫室自主供電，有效降低農場整體消耗
- ✓ 提升科技農業競爭力，邁向2050淨零碳排目標



智慧建築 | 鈣鈦礦創能門窗

從「展示」走向「日常資源循環」

聚賢 SHOWROOM 落地窗升級，讓建築主動參與發電節能





資源循環與低碳製程

氣體回收、純化與再利用



再生能源



氫氣



氦氣



針對再生能源、氫氣及氦氣進行回收處理，轉化為可重複利用的資源。

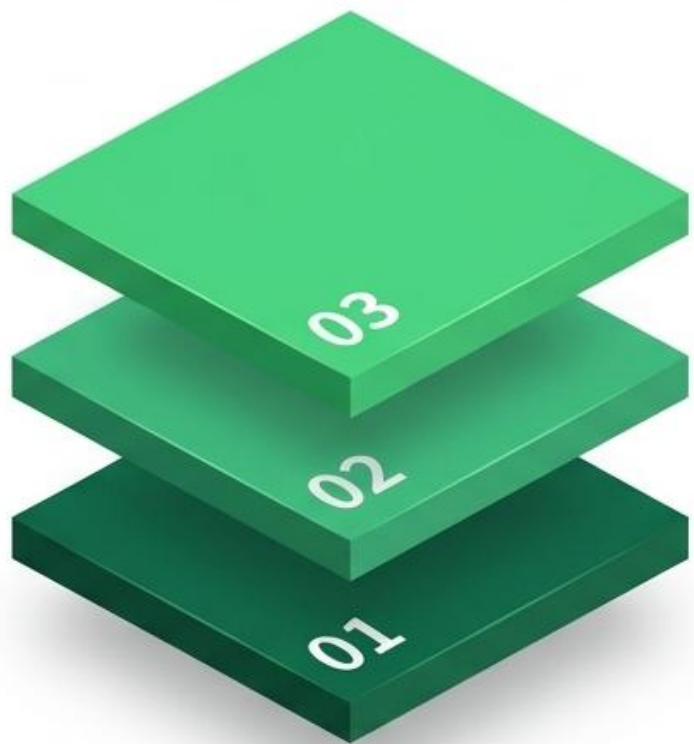
超臨界 CO₂ 清洗與萃取



運用超臨界 CO₂ 流體特性，執行高效率的零件清洗或材料成分萃取。



建立關鍵技術堆疊優勢



跨領域不同場景技術應用

雷射光學 材料科學 自控領域 機械加工

多重技術堆疊大幅提高模仿難度

綜合軟硬體整合能力

無縫串聯底層硬體與控制系統，提高
產品服務綜效

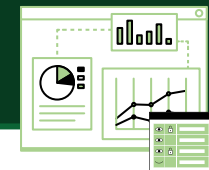
自主研發綠色多元產品

節能減碳 材料輕量 全循環回收

全面對齊淨零策略，實質優化客戶端
流程效率

03. 創新產品與專利





聚賢研發的核心量能

雷射光源情境應用實驗室



雷射光源情境應用實驗室

運用在焊接、切割、電性量測之設備開發



配合廠務工程開發 現場設備及工具



廠務工程

開發適合現場使用之設備及電動手工具
加速工作效率



零組件耗材設計開發

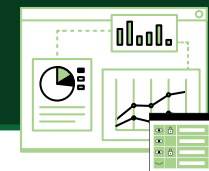


零組件耗材設計開發

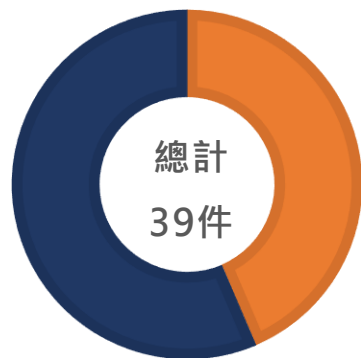
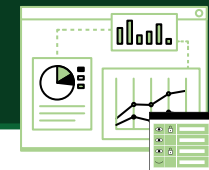
配合客戶需求提供客製化零組件設計、開發、製作服務



全方位售服及技術支持



創新能力-專利佈局

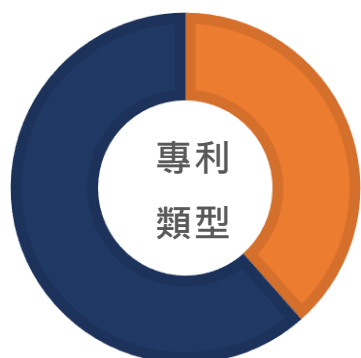


有效專利 48%(19件)

審查中專利 52%(20件)

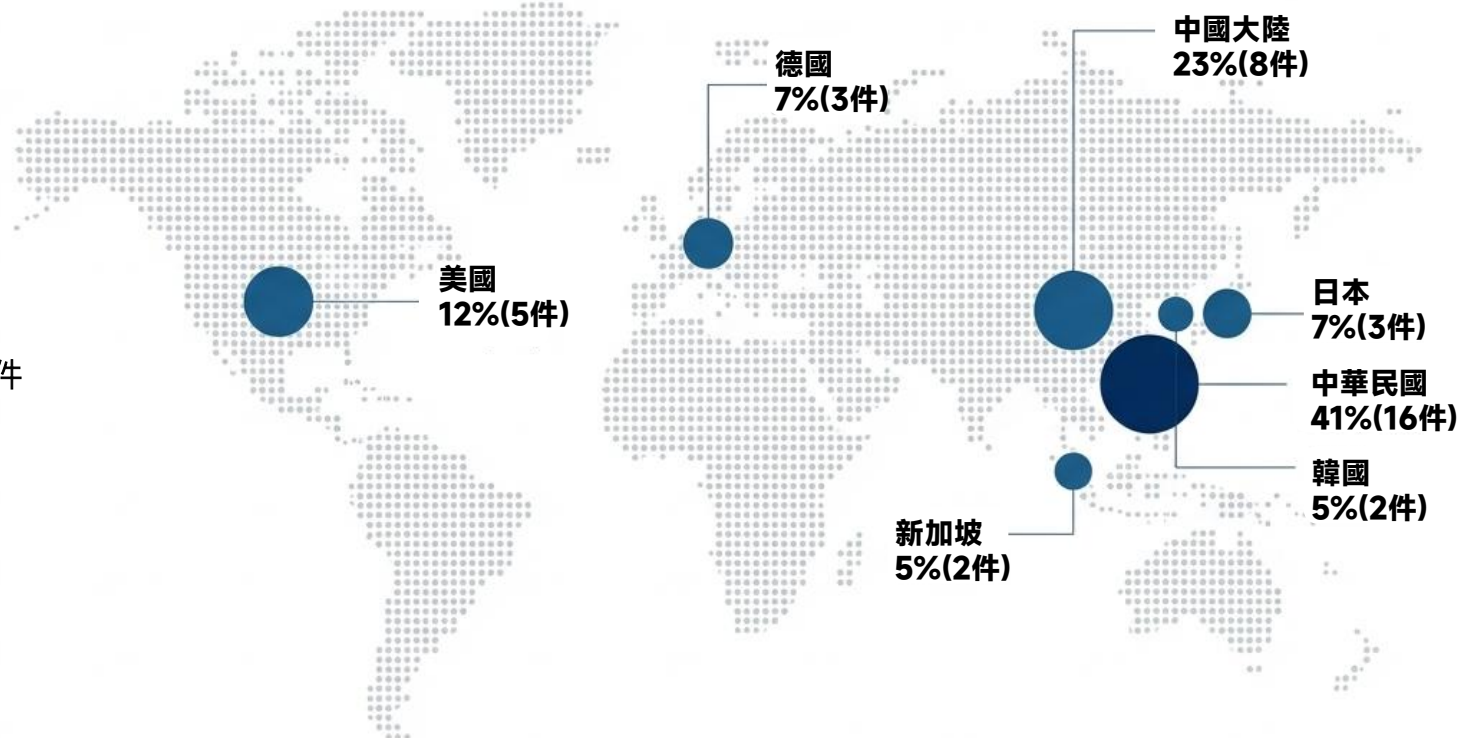
有效專利：發明5件、新型14件

審查中專利：發明19件、新型1件



新型專利 38%(15件)

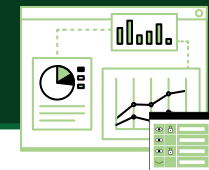
發明專利 62%(24件)



04.聚賢永續行動







公司治理

營業秘密
性別平等
激勵獎金
EAP制度
在職進修

社會責任

公益假
樂活假
公益信託
美麗台灣
產學合作

環境關懷

綠色製程
低碳通勤
能源轉換
推動無紙化
永續發展委員會





以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾



榮獲 **2024 MM ESG Award**



供應商 ESG 聯合提案：
卓越影響獎 **伍獎**





以卓越技術驅動產業升級，以永續發展實踐企業承諾

【創新研發 Innovation】



2025 台灣創新技術博覽會 (TIE)
發明競賽 銅牌

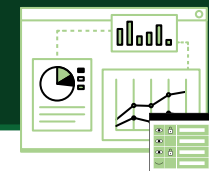
【永續經營 ESG】



2025 第十八屆台灣企業永續獎 (TCSA)
企業永續報告書 銅獎

05.業務發展暨財務績效





產業趨勢與市場預測

市場規模與增長預測



關鍵技術創新



先進封裝與Chiplet
異質整合



2nm節點採用EUV
顯影技術與GAA電
晶體



第三代半導體材料
SiC和GaN應用增長

終端應用驅動



汽車電子



高性能計算



網絡通訊

供應鏈與區域發展



區域性在地化生產



供應鏈韌性

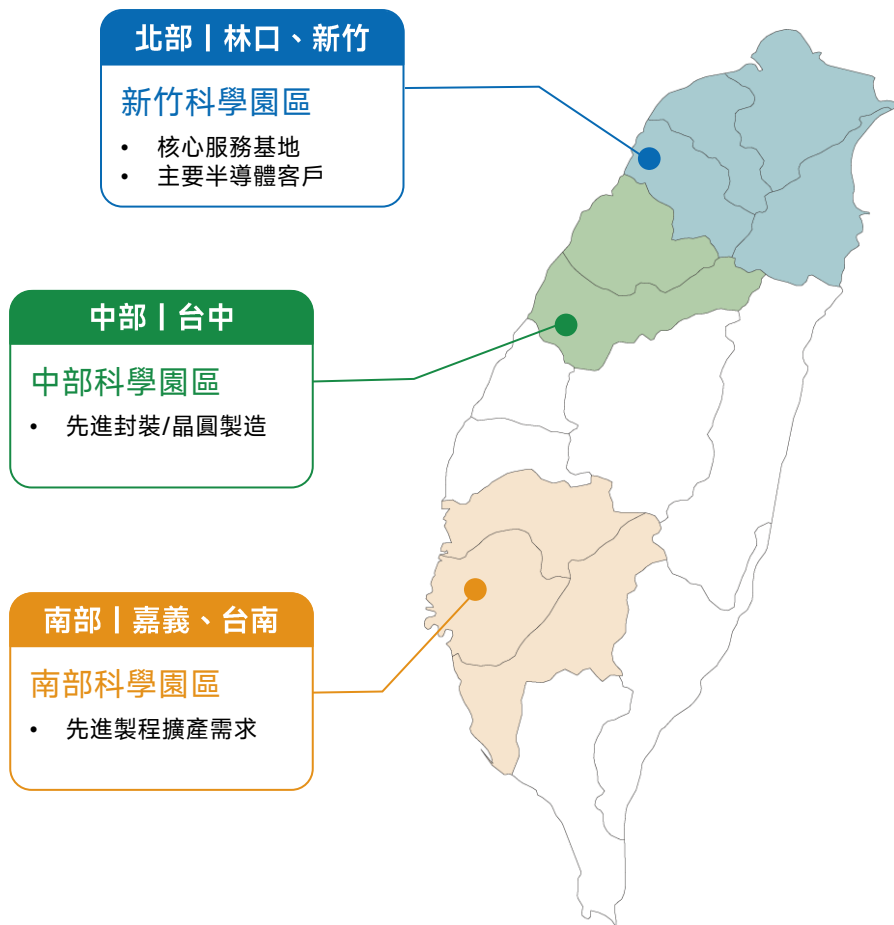


晶圓產能管理



在手訂單國內分布圖

三大科學園區為核心服務據點 緊貼半導體先進製程產能聚落



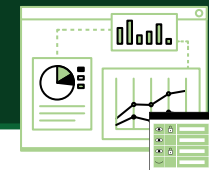
在手訂單金額

約
NT\$ **20.0** 億

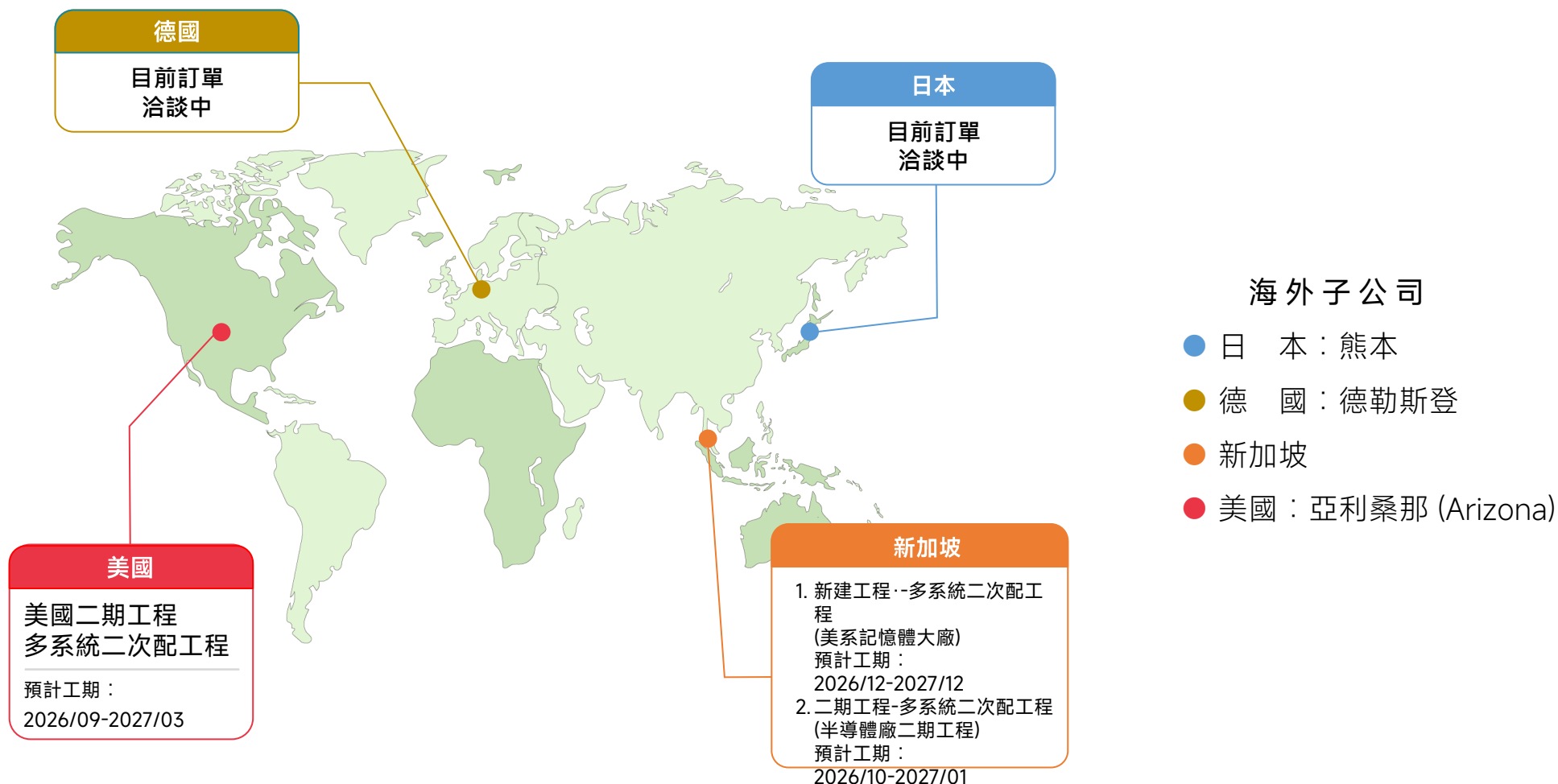
2026

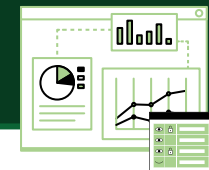
訂單能見度維持高檔

訂單客戶遍及全台各大**半導體**、**記憶體**大廠等相關客戶

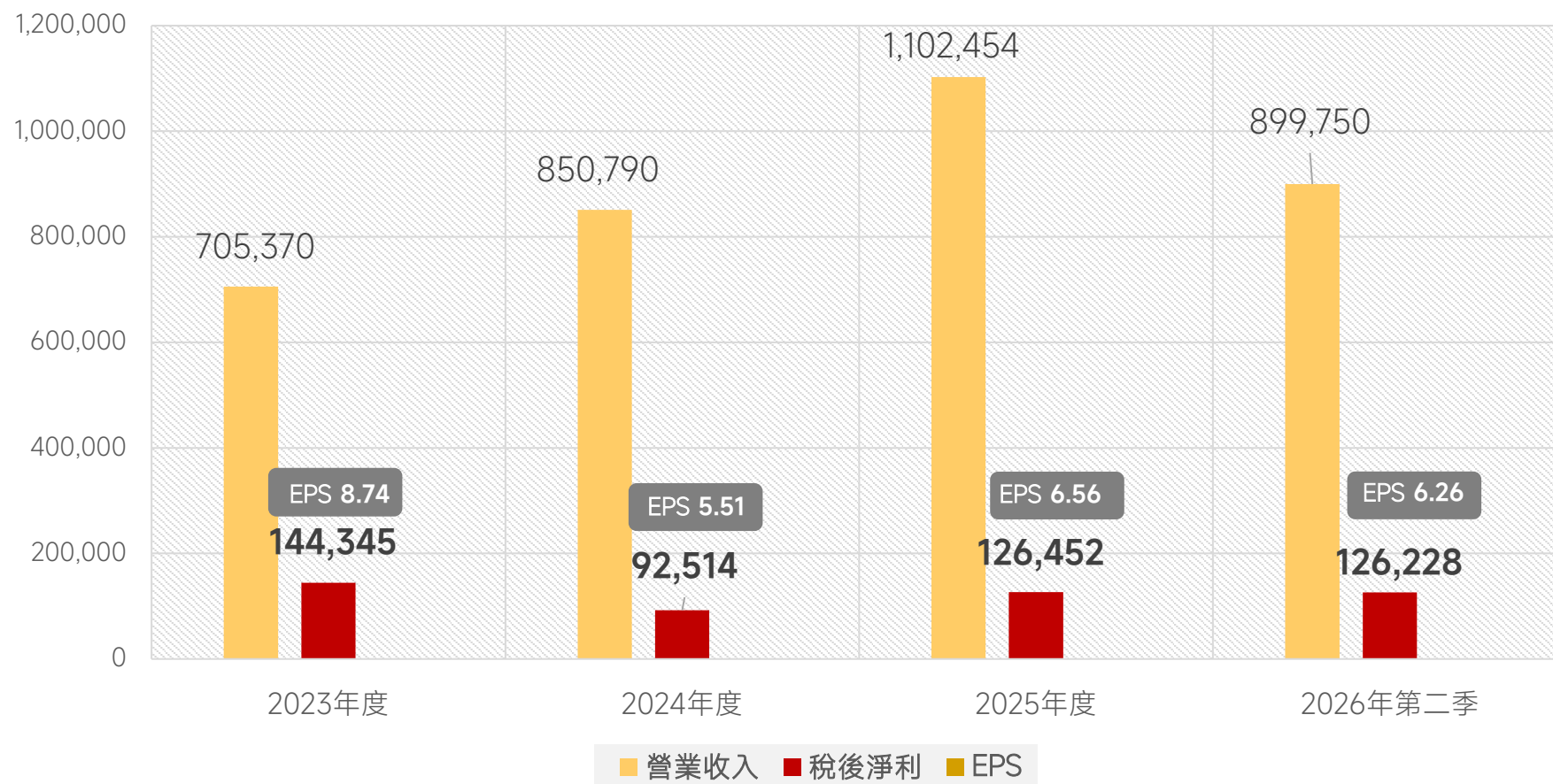


在手訂單海外分布圖

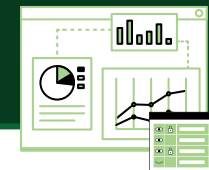




2023~2026年第二季經營績效



註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



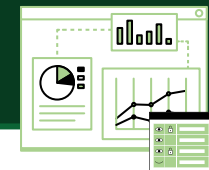
綜合損益表

2023~2026年第二季

單位：新台幣仟元

會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	2026年第二季	YOY(%)
營業收入	705,370	850,790	1,102,454	899,750	113.44%
毛利率	39.93%	31.26%	27.52%	29.82%	2.16%
營業費用	102,357	127,155	149,874	91,618	24.18%
營業利益	179,304	138,813	153,593	176,706	258.71%
營業利益率	25.42%	16.32%	13.93%	19.64%	68.01%
稅後淨利	144,345	92,514	126,452	126,228	215.44%
純益率	20.46%	10.87%	11.47%	14.03%	47.84%
EPS(元)	8.74	5.51	6.56	6.26	192.52%
權益報酬率	34.82%	18.67%	18.72%	28.64%	127.30%

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



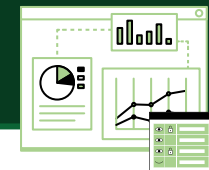
資產負債表

2023~2026年第二季

單位：新台幣仟元

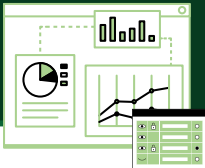
會計項目/期間	2023年度	2024年度	2025年度	2026年第二季	YOY(%)
現金及約當現金	255,325	208,743	610,574	450,246	4.40%
應收帳款	79,003	192,543	99,413	299,717	343.34%
存貨(含合約資產)	340,996	400,201	486,005	823,743	77.25%
總資產	754,999	1,008,599	1,483,072	1,896,260	59.41%
流動負債	253,107	340,945	478,222	750,789	155.50%
非流動負債	20,753	157,763	163,916	223,219	64.98%
負債總計	273,860	498,708	642,138	974,008	126.96%
重要財務指標					
負債比	36.27%	49.45%	43.30%	51.36%	42.35%
存貨周轉率(次)	1.29	1.58	1.80	1.93	39.86%
應收帳款週轉率(次)	6.23	6.27	7.55	9.02	39.20%

註：財務數據業經安永聯合會計師事務所查核簽證或核閱



採季配股利方式，兼顧成長與穩定收益

年度	每股現金股利 / 盈餘配發率
2024年第一季	0.50元
2024年第二季	0.50元
2024年第三季	0.59元
2024年第四季	1.20元
2024年度合計	2.79元 / 51%
2025年第一季	0.65元
2025年第二季	0.74元
2025年第三季	0.75元
2025年第四季	1.60元
2025年度合計	3.74元 / 59%
2026年第一季	0.80元 / 45%
2026年第二季	2.00元 / 44%



研發費用占營收比重

單位：新台幣仟元

年度	2024年度			2025年度			2026年第二季		
公司名稱	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%	研發費用	營業收入	比重%
聚賢研發	13,018	850,790	1.53	21,911	1,102,454	1.99	9,172	899,750	1.02
漢科	19,497	5,487,092	0.36	17,445	5,245,806	0.33	10,026	2,944,266	0.34
銳澤	4,721	1,951,312	0.24	10,932	2,564,418	0.43	5,164	1,310,407	0.39

資料來源：各公司各期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

謝謝您的聆聽

Q & A



官方網站



2025 永續報告書

永續報告書下載

